

Das Dampfphasen-Löten von SMD-Bauteilen



1 Einleitung? Durch die anhaltenden Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der SMD-Technologie (Surface Mounted Devices) sind diese Flachbaugruppen zu einem produktionstechnischen Bestandteil geworden. Aufgrund der jahrelangen Erfahrungen auf dem Gebiet der Reflow-Löttechnik soll sich dieser Aufsatz im besonderen mit dem hierzu angewandten Dampfphasen-Löten, auch bekannt unter dem Begriff "Vapour Phase Soldering" befassen. Die wesentlichen Vorteile des Dampfphasen-Lötens beim Einsatz von SMD-Bauteilen sind: - keine Temperaturkontrolle des Lötprozesses ?notwendig - keine aufwendigen Temperaturkurven zum Einstellen der Maschine - keine Probleme bei unterschiedlichen Bauteilen ?und Plattengrößen - keine Kapazitätsprobleme - keine Oxidation beim Löten - keine hohen Energiekosten - keine Probleme bei Flexschaltungen - keinen Tombstone-Effekt - keine Korrosionsprobleme - kein Wasseranschluß bei Verwendung von Kühlaggregaten notwendig. Nachstehend sollen im Detail die Unterschiede zwischen Stand- und Inline Systemen erläutert sowie ein Überblick über Nachreinigungssysteme gegeben werden.

Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

ermäßigter Preis 2,52 €

2,70 €

Netto-Preis: 2,52 €

Enthaltene MwSt.: 0,18 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)